

Cutting Edge

第67期事業報告書

平成17年4月1日～平成18年3月31日

証券コード：6146



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



DISCOの明日を 見つめてください。

p3 — 社長インタビュー
DISCO VISION

p7 — DISCO Technology
TAIKO プロセス

DISCO Story……………②

p14 — 新社名「DISCO」で世界へ!

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」 3つのコア技術を深めることで、 ディスコは産業と人の暮らしに貢献しています。

高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは...

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。

ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。

「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、

日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという想いが込められているからです。

遠い科学を身近な快適につなぐとは...

科学は日々進歩しています。しかしどれほど進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。

ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

ディスコが追い求める成長とは...

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダーとの価値交換を通じ、

長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。

ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

Contents

- ② 株主の皆様へ
- ③ 社長インタビュー
- ⑤ DISCO News
- ⑥ DISCO Business
- ⑦ DISCO Technology
- ⑧ DISCO Values
- ⑨ 連結財務諸表
- ⑩ 単体財務諸表
- ⑫ 財務指標（連結）
- ⑬ 会社情報および株式の状況
- ⑭ DISCO Story...e

To Our Shareholders

株主の皆様へ

DISCO VISIONの実現を見据え、 着実に歩みを進めてまいります。

当期経営環境と業績

2006年3月期の当社を取り巻く経営環境としては、2005年夏ごろには前期より続いていた調整局面が終了し、年度後半にかけて大きく回復するというものでした。半導体市場では、携帯型オーディオプレーヤーのヒットに加えて、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国など経済新興国)でもパソコンや携帯電話などが普及期に入り、大きく需要を伸ばした点が特徴的でした。このような旺盛な半導体需要が半導体メーカーの稼働率を押し上げ、設備投資が回復したことで当社の精密加工装置の販売増につながりました。加えて、業績の安定化を目指し、注力してきた精密加工ツールの売上が好調に推移し、当期の業績を大きく牽引しました。これらにより、売上高は14.2%アップの68,885百万円、経常利益は44.0%アップの14,410百万円となり、2001年3月期に次ぐ過去2番目の業績を達成することができました。

DISCO VISIONの達成に向けて

当社のミッション実現に一歩でも近づくために、2010年時点でのあるべき姿をDISCO VISIONと定義し、現在その実現に向けて全社を挙げて取り組んでいます。当期はこの計画実現に向けた準備期間の最終年と位置づけて臨みました。その結果、期初に掲げた各種のトラッキング指標の年次目標を



代表取締役社長
溝呂木 斉

概ねクリアし、これまでの取り組みを実績に結びつけるための基盤づくりができたものと自負しています。また、今後数年は、デジタル機器などの最終製品の拡大や、地域市場のさらなる伸長が予測され、さらにはFIFAワールドカップその他の世界的ビッグイベントが相次ぎ開催されるなど、半導体関連市場の一層の拡大が見込まれます。そのような環境の中で、当社は「Kiru・Kezuru・Migaku」技術のさらなる深化と先端技術への取り組みを強化してまいります。規模の拡大に伴い不足する人的リソースの獲得・育成など課題も山積しておりますが、各種指標の着実な達成に邁進しつつ、2010年のDISCO VISION実現に向け着実に歩みを進めてまいります。

2006年6月

代表取締役社長

Interview with the President

社長インタビュー

Q

今後の市場環境の見通しについて聞かせてください。

A

2008年の北京五輪までは堅調な推移を見込んでいます。

現在、通信・電子機器や自動車など半導体を用いる最終製品は拡大の一途をたどっており、過去に体験してきたような半導体需要のピークとボトムとの差は徐々に緩和されつつあります。当期も携帯電話の出荷台数が伸び、パソコンも好調でした。さらには薄型テレビのヒットや、モバイル、ストレージ系の伸長など、最終製品の好況が半導体メーカーの設備投資を促し当社の業績を牽引しました。また、地域的にも、先進国からBRICs市場へデジタル系最終製品のニーズが拡大し半導体需要を大きく押し上げるなど、当社のビジネスにとってフォローの風が吹きました。このトレンドは、ドイツで開催中のFIFAワールドカップや2008年開催予定の北京五輪まで、薄型テレビやDVDなどの需要増によって持続されるものと見込んでいます。

Q

さらなる成長に向けた事業戦略を聞かせてください。

A

新技術の飽くなき追求と市場変動に強いビジネスモデルの構築が鍵となります。

当社は「Kiru・Kezuru・Migaku」というコア技術の絶え間ない深化を図りつつ、半導体需要の波に影響されにくい収益構造の強化を進め、先取的な新技術への取り組みに経営リソースを投入していくことを事業戦略としています。2006年3月期の増収を底上げた精密加工ツールの販売の好調は、シリコンサイクルの変動に強い体質を構築するための取り組みが成果となって表れた一例です。また、今後の需要増が見込まれるウェーハ薄化技術を業績伸長のための重要技術と認識し、当期中にTAIKOプロセスや超音波ダイシングなどの新しいアプリケーション技術を市場に先行投入し、既存の薄化対応装置受注とのシナジーを期しています。また、市場を常にリードするために、需要の調整期に先端技術の研究開発を集中的に行い、好況期に量産体制を円滑に立ち上げられるビジネスモデルの構築を最重要経営課題と捉えています。

DISCO VISION とは

2010年時点のディスコの「あるべき姿」を売上高や利益率等の数値的目標に偏らず、6つの側面から描き出したものです。6つの像はそれぞれ深く関連しています。



Q DISCO VISION達成までのシナリオを話してください。

A 着実に指標をクリアしつつ企業文化の質の向上を目指します。

DISCO VISIONの達成に向け、既に基礎体力は整いつつあります。精密加工ツールビジネスの過去最高売上の達成などによって、当期の単体売上高経常利益率は23.9%となり、トラッキング指標における年次目標をクリアし、4年累計で20%というビジョンの達成に向け好ましいスタートを切ることができました。また、経費・原価の構造的な5%削減目標についても2年連続で達成しています。こうした目に見える指標の達成とともに重要なのが、企業としての質の向上です。常に業務の効率化と質の向上を目指した組織の構築、時代のニーズを的確に掴む鋭敏なセンサーを磨き、お客様のご満足を求めて止まない社員の育成など、総合的な企業文化の質の向上こそがビジョンの達成とディスコの継続的な成長にとって不可欠です。

Q 配当についての考え方を聞かせてください。

A 業績連動型配当により株主利益の増大と企業成長の調和を図ります。

当期から、株主の皆様への配当を業績連動型に改めました。具体的な政策としては、配当性向20%を目指し、業績低迷時にも、最低、年間20円の配当を行います。また、現預金残高が、企業運営に必要な資金を上回った場合には、超過資金の3分の1を配当に上乘せし、株主の皆様への積極的な還元に努めます。こうした政策により、長期に保有していただく株主の皆様のご期待にお応えできると考えております。なお3期連続で赤字になった場合は、最低安定配当額の見直しをする場合があります。

VISIONの実現に向け、足元を固めつつ、成長を遂げてまいります。



今期のDISCOを振り返ります。

Management



米インテル社よりSCQI賞を6年連続受賞

当社は、インテル コーポレーション(本社:米国カリフォルニア州サンタクララ)より、2005年度SCQI賞(Supplier Continuous Quality Improvement Award)を受賞いたしました。この賞はインテル社に対し、優れた製品やサービスを供

給し、インテルの成功に最も貢献した企業を表彰するものです。当社は、高精度なシングュレーションシステム、ダイシングソーおよびバックグラインダを提供したサプライヤーとして6年連続の受賞となります。

Business



パッケージ切断用
ダイシングソー
「DFD6340」

パッケージ切断用ダイシングソー絶好調

2005年度下期は、上期からの市場回復傾向が継続し、携帯電話などの最終製品の需要に支えられ、半導体後工程の生産拠点となっているアジア地域を中心に、積極的に設備投資が行われました。その結果、当社の精密加工装置の販売状況も良好なものとなりました。なかでも、売上を牽引した商品群の一つが、半導体パッケージを切断するダイ

シングソーでした。現在、半導体のパッケージ技術の進展により、パッケージの個片化に際して精度の高い切断が要求されているため、ダイシングソーの使用が一般的になってきています。今後もパッケージ切断など新しい「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」のニーズを捉えたソリューションの提供を行っていきます。

Event



SEMICON Chinaの様子

世界各地のSEMICON(セミコン)に出展

当社は、1975年より半導体製造装置メーカーの業界団体であるSEMIの主催による世界各地の展示会に出展しています。2005年12月には千葉県幕張メッセで開催されたSEMICON Japan 2005に出展し、TAIKOプロセスをはじめとして新技術、

製品の紹介を行い、3日間の会期中、たくさんの方がご来場くださいました。また、SEMICONは世界各地で開催されており、2006年1月には韓国ソウル、3月には中国上海にて技術や製品の展示を行いました。

流行の携帯音楽プレーヤーを支えるディスコのコア技術

この一年で大ヒットしたデジタル製品といえば、やはり携帯型音楽プレーヤー。かつてはカセットテープやMDで聴いていたものが、1,000曲以上もの音楽を一つのプレーヤーに入れ、持ち歩ける時代になりました。

このヒットの裏側には、一つの半導体デバイスが大きな役割を果たしています。NAND型フラッシュメモリーと呼ばれる記憶用チップです。このチップは消費電力が低く、高速にアクセスでき、大容量の記憶容量を持つ半導体で、デジタルカメラのメモリーカードなどに使用されています。現在、半導体市場に占める割合はそれほど大きくありませんが、携帯用音楽プレーヤーのヒットやアプリケーションの裾野の広がりが期待されることから、半導体メーカーも大きな設備投資を実施する予定で、今後もっとも成長すると見られるマーケットセグメントです。

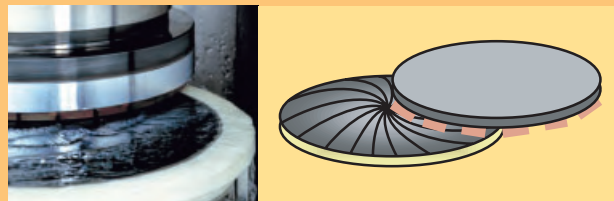
NAND型フラッシュメモリーは、半導体の中でも特に薄く小さいことが要求されます。このようなチップの製造に、ディスコの培ってきた技術・たくさんのノウハウが詰まっています。

薄く研削したウェーハの反り・割れを防ぐストレスリリーフ、研削水の水圧調整、的確な精密ダイヤモンドブレードの選択、装置設定の最適化なども一つの半導体チップの品質に欠かせません。実は、ディスコのこういった技術ノウハウも耳元のアーティストたちの歌声を支えているのです。



ディスコの技術を用いて極小化したUSBメモリー

◎バックグラインディング(裏面研削)加工図



IC回路の形成されたシリコンウェーハ(厚さ725~775 μm)を75 μm 程度まで平坦に削ります。

◎ダイシング加工図



精密ダイヤモンドブレードを高速で回転させ、一つ一つのチップに切り分けます。

TAIKOプロセスの開発

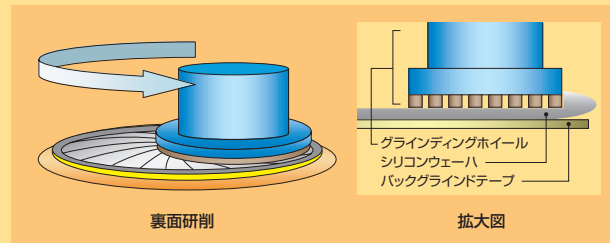
～ウェーハバックグラインディングの新たな加工方法～

電子機器の小型化、高機能化による高密度実装のトレンドを受け、SiP(System in Package)技術のニーズが高まっています。そうした状況の中で、ウェーハ薄化の必要不可欠な加工技術として注目を集めており、薄化プロセスによって発生するウェーハの反りから生じる割れや欠け、搬送時の破損などのリスクを軽減するための新たな技術が求められています。当社が開発した「TAIKOプロセス」は、従来のバックグラインディングとは異なり、ウェーハ研削の工程でウェーハ裏面外周部の約2mm程度を研削せずに残し、内側のエリアのみを研削して薄化を実現する新技術です。



研削したウェーハが「太鼓の鼓面」に似て見えることから、TAIKOと名付けました。

◎TAIKOプロセス



ディスコ独自の技術により、外周部を残して内側エリアのみ薄化研削します。

TAIKOプロセスのメリット

この技術の開発により、さまざまなメリットが提供可能となりました。まず、ウェーハ外周枠を残すことでウェーハの反りを抑え強度を向上させ、エッジチップングに起因するウェーハ破損が発生しなくなりました。また、ウェーハのハンドリング性が向上し、薄化後の加工が容易になるなどのメリットが生まれています。さらに、ウェーハ薄化後に、高温のプロセス(メタライゼーションなど)が必要なデバイスの場合、これまでウェーハに接着剤でガラスを貼り付けるハードサブストレート法を用いていましたが、TAIKOプロセスによって、薄化後の高温工程での接着剤によるガス発生を解消し、シンプルな形状によるパーティクル(微粒子)付着の低減を実現しました。また、研削時に外周部に荷重がかからないことで段差のあるウェーハの研削が容易になりました。



【左】
TAIKOウェーハ
(50 μ m厚仕上げ)

【右】
通常研削ウェーハ

TAIKOウェーハは、外周部が残っているため、反りもなくハンドリングが容易

高度なKiru・Kezuru・Migaku技術

ディスコは「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」ことを自分たちの社会的使命である、と定義しています。

工業用研削砥石メーカーとしてスタートしたディスコは、独自技術の開発や差別化に徹的にこだわってきました。そしてこれからも「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」のスペシャリストとして社会の発展に寄与していくことで、企業として長期的な成長を確固たるものにしていきたいと考えています。

では、ディスコの技術はどのように活かされているのでしょうか？

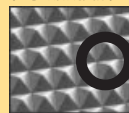
ディスコの技術の真髄は、肉眼では確認することが出来ません。

半導体や電子部品は、ミクロン単位の精度が品質を決定します。シリコン、ガラス、セラミックスといった素材を厚さ数十ミクロンの精密ダイヤモンド砥石を用いて、高速回転させるこ

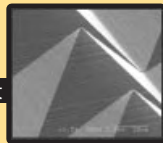
◎シリコンウェーハV溝加工

- ・切り込み深さ:50 μ m
- ・カットインデックス:100 μ m

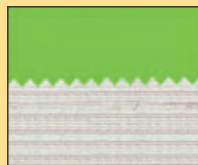
(電子顕微鏡画像)



一部拡大

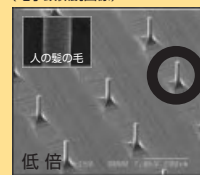


断面写真



◎シリコン柱残し加工：髪の毛よりも細い柱を切り出します

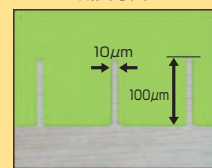
(電子顕微鏡画像)



拡大



断面写真



とで切断する。こうして切り出されたチップは、パソコンや携帯電話の頭脳となり、高度情報社会のエンジンとして機能しています。

現在、技術革新のフロンティアはどうなっているのでしょうか？

ディスコでは、ハイテク製品の生産技術として主流となっている精密ダイヤモンド砥石を用いた切断・研削技術のさらなる精度の追究を続けているのはもちろん、砥石だけではない加工技術を確立しています。レーザー、ウォータージェットによる切断技術、さらにプラズマ反応を利用したエッチング技術など、お客様の技術ニーズに応えるため、「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」のフロンティアはますます広がっています。

技術は日々進化し続けます。

ディスコは人々の身近な快適を実現するために、「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」の専門領域を探究し続けます。

Financial Statements

連結財務諸表(要旨)

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	第67期 平成18年 3月31日現在	第66期 平成17年 3月31日現在
流動資産	64,279	50,517
固定資産	35,039	34,321
有形固定資産	29,057	29,406
無形固定資産	758	412
投資その他の資産	5,223	4,502
資産合計	99,318	84,839

(単位:百万円)

科目	第67期 平成18年 3月31日現在	第66期 平成17年 3月31日現在
流動負債	25,493	14,966
固定負債	3,123	13,843
負債合計	28,617	28,809
少数株主持分	424	302
資本金	13,412	9,885
資本剰余金	14,494	10,967
利益剰余金	41,899	35,024
その他有価証券評価差額金	303	137
為替換算調整勘定	205	△ 259
自己株式	△ 39	△ 29
資本合計	70,276	55,726
負債、少数株主持分及び資本合計	99,318	84,839



連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	第67期	第66期
	自 平成17年4月 1 日 至 平成18年3月31日	自 平成16年4月 1 日 至 平成17年3月31日
売上高	68,885	60,320
売上原価	32,734	29,740
販売費及び一般管理費	22,201	20,710
営業利益	13,949	9,869
営業外収益	590	457
営業外費用	129	319
経常利益	14,410	10,006
特別利益	16	377
特別損失	1,041	1,303
税金等調整前当期純利益	13,385	9,080
法人税、住民税及び事業税	5,077	3,476
法人税等調整額	18	188
少数株主利益	58	114
当期純利益	8,230	5,301

連結剰余金計算書

(単位:百万円)

科 目	第67期	第66期	
	自 平成17年4月 1 日 至 平成18年3月31日	自 平成16年4月 1 日 至 平成17年3月31日	
資本剰余金の部	資本剰余金期首残高	10,967	10,664
	資本剰余金期末残高	14,494	10,967
利益剰余金の部	利益剰余金期首残高	35,024	30,970
	利益剰余金増加高	8,230	5,301
	利益剰余金減少高	1,355	1,246
	利益剰余金期末残高	41,899	35,024

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	第67期	第66期
	自 平成17年4月 1 日 至 平成18年3月31日	自 平成16年4月 1 日 至 平成17年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	12,322	7,281
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,409	△ 7,432
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,031	△ 2,056
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	230	68
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	5,111	△ 2,139
VI 現金及び現金同等物の期首残高	16,891	19,031
VII 現金及び現金同等物の期末残高	22,003	16,891

Financial Statements

単体財務諸表(要旨)

単体貸借対照表

(単位:百万円)

科目	第67期 平成18年 3月31日現在	第66期 平成17年 3月31日現在	
資産の部	流動資産	55,192	43,274
	固定資産	36,535	34,956
	有形固定資産	26,354	27,149
	無形固定資産	537	173
	投資その他の資産	9,643	7,634
資産合計	91,727	78,231	
負債の部	流動負債	22,249	12,133
	固定負債	2,212	12,963
	負債合計	24,462	25,096
資本の部	資本金	13,412	9,885
	資本剰余金	14,494	10,967
	利益剰余金	39,094	32,173
	その他有価証券評価差額金	303	137
	自己株式	△ 39	△ 29
	資本合計	67,265	53,134
	負債及び資本合計	91,727	78,231

単体損益計算書

(単位:百万円)

科目	第67期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	第66期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
売上高	55,668	46,480
売上原価	26,878	23,098
販売費及び一般管理費	17,818	16,949
営業利益	10,971	6,432
営業外収益	2,378	1,842
営業外費用	20	191
経常利益	13,329	8,083
特別利益	13	44
特別損失	924	1,201
税引前当期純利益	12,417	6,926
法人税、住民税及び事業税	4,229	2,679
法人税等調整額	△ 84	△ 563
当期純利益	8,272	4,811
前期繰越利益	13,688	10,225
自己株式処分差損	-	0
中間配当額	482	482
当期末処分利益	21,479	14,554

利益処分

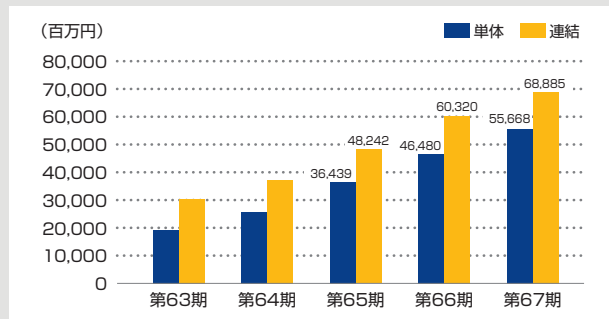
(単位:百万円)

科目	第67期 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	第66期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
当期末処分利益	21,479	14,554
任意積立金取崩額	5	3
買換資産圧縮積立金取崩額	4	3
国庫補助金等圧縮積立金取崩額	0	0
合計	21,484	14,558
利益処分額	1,264	869
配当金	1,174	804
役員賞与金	90	65
次期繰越利益	20,219	13,688

Financial Data

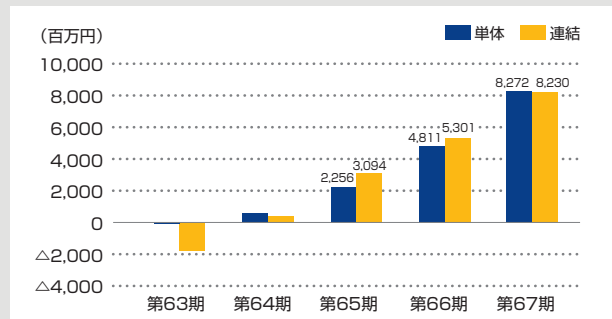
財務指標（連結）

◎売上高



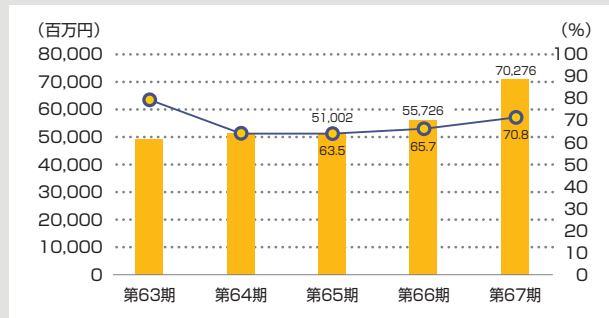
携帯電話、パソコン、携帯音楽プレーヤーなど最終製品需要の伸びにより、半導体メーカーの設備投資が活発化しました。特にアジア地域における需要の高まりを受けて、前年比14.2%の増加となりました。

◎当期純利益



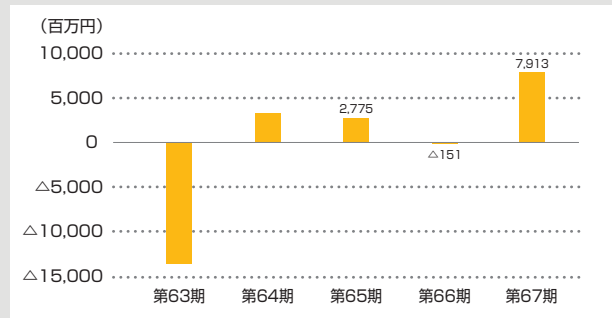
売上高の増加に伴い、前年比29億29百万円増加し、82億30百万円となりました。また、当期売上高純利益率は8.8%から11.9%と3.1ポイントの上昇となりました。

◎株主資本・株主資本比率



株主資本は、当期純利益の増加と新株予約権付社債の償還により、前年比145億50百万円の増加となりました。株主資本比率は、65.7%から70.8%と5.1ポイント上昇しました。

◎フリーキャッシュ・フロー



好調な業績に支えられ営業キャッシュ・フローが増加したことを受けて、前年比80億64百万円増加し、79億13百万円（前年は1億51百万円の支出）となりました。

DISCO Information

会社情報および株式の状況

■ 会社概要

本店所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金	13,412百万円(2006年3月末日現在)
従業員数	1,259名(2006年3月末日現在)
主な事業内容	精密加工装置 <ul style="list-style-type: none"> → 製造および販売 → メンテナンスサービス → オペレーションやメンテナンスの研修サービス → 解体リサイクル事業 → リースおよび中古品販売 精密加工ツール → 製造および販売 精密部品の有償加工サービス
事業所	本社・R&Dセンター 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)
国内拠点	大阪支店、九州支店、仙台営業所、名古屋営業所、諏訪営業所

■ ディスコグループ関連会社

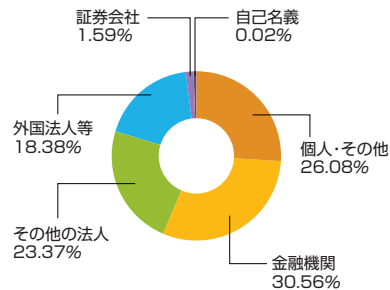
国内法人	株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ 株式会社ディーエスディー 株式会社ディーエスディー九州
海外法人	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. JETSIS INTERNATIONAL PTE LTD DD Diamond Corporation S.E.A. Utensili Diamantati S.p.A. DISCO-SEA AMERICA, INC. TECNISCO (Suzhou) Co., Ltd

■ 役員 (2006年6月23日現在)

代表取締役社長	溝呂木 斉
常務取締役	関家 圭三 関家 一馬
取締役	関家 英之 梶山 啓一 溝呂木 隆夫 田村 隆夫
常勤監査役	玉利 晋
監査役	古川 深志 浅海 芳久 木谷 孟

■ 所有者別株式数分布状況

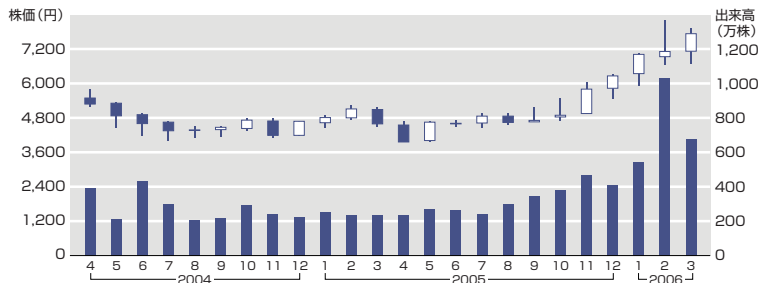
(2006年3月末日現在)



■ 株式概要 (2006年3月末日現在)

上場証券取引所	東京証券取引所第一部上場(証券コード6146)
発行済株式総数	33,562,718株
株主数	13,112名
大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社: 3,059千株/9.11% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社: 2,813千株/8.38% 株式会社ダイイチ企業: 1,998千株/5.95% 株式会社ダイイチホールディングス: 1,998千株/5.95% 株式会社OCTAGON LAB: 1,704千株/5.08% 関家 臣二: 1,398千株/4.17% 関家 憲一: 1,036千株/3.09% 資産管理サービス信託銀行株式会社: 920千株/2.74% 株式会社オレンジコーラル: 846千株/2.52% 株式会社あおぞら銀行: 750千株/2.23%

■ 株式チャート



DISCO Story………… 2

【全6回シリーズ】

〈1968年～1977年〉

砥石メーカー、自前で半導体製造装置を創り出す 新社名「DISCO」で世界へ！



DAD-2H

ディスコの前身である第一製砥所は、1968年に厚さ40マイクロメートルの超極薄砥石「ミクロンカット」を開発し、翌年の日刊工業新聞社「十大新製品賞」を受賞。世に広くその名を知られるようになりました。

海外進出への転機は意外なところからやってきます。この受賞の後、ニュースを見た日系米国人から、「半導体を加工するのに面白い。米国で有望な商品となるからパートナーシップを結び販売してみないか」との誘いを受けました。

現地での会社設立に際しては、第一製砥所が発音しにくいので米国で流行していた社名の短縮化を取り入れ、英文名Dai-Ichi Seitosyo CO., Ltd.の頭文字をとって「DISCO」と命名。1969年12月、DISCO ABRASIVE SYSTEM, INC. が米国で発足し、初めての海外進出を果たしたのです。



第一製砥所の砥石ラインナップ
(1968年当時)

そんな中、大きな壁が立ち現れました。当時の第一製砥所は研削砥石の専門メーカーであり、実験機製作は外部協力会社と共に行っていたものの、本格的な装置開発となると工作機械メーカーは取り合ってくれません。

「いいもの(砥石)ができたのに、その性能を発揮される機械が世の中にない。しかし、目の前にビジネスチャンスがある…。もうウチでやるしかない。機械をつくらう！」たった一人のプロジェクトがガレージでスタートしました。

機械装置の設計・製造の経験が全くない中、メンバーは4人に増え、試行錯誤を繰り返し、ミクロンカット開発から7年後の1975年、現在のダイシングソーの原型である「DAD-2H」がとうとう完成しました。そして、その年のシリコンバレーで開かれたセミコン・ウェスト出展にこぎつけます。

DAD-2Hは会期中、不眠不休でシリコンウェーハを切断するというデモ運転を続け、「止まらない装置」として驚異と絶賛の旋風を巻き起こし、500件を超える商談につながりました。

2年後の1977年、本日も株式会社ディスコと社名変更し、先端半導体装置産業の担い手として、新たな一歩を踏み出しました。

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月末日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金 受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年9月30日
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日とします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 (同送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(フリーダイヤル)
同取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店
公告方法	電子公告(当社のホームページに掲載します) ただしやむを得ない事由により電子公告ができないときは 日本経済新聞に掲載します。
証券コード	6146

さらに詳細なIR情報は こちらからどうぞ。

当社では、株主や投資家の皆様向けにIRサイトを設けております。株価や株式に関するお手続きなどのお知らせのほか、IR関連のお知らせを最新のものから過去5年にさかのぼって検索できる「IRニュース」や株主総会などのスケジュールを掲載した「IRカレンダー」などコンテンツを充実させております。どうぞお気軽にアクセスしてみてください。



<http://www.disco.co.jp/>

“Cutting Edge”とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほかにも、「最先端」という意味があります。ディスコグループの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解いただくために、常に最先端の技術を保有しながらも、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコグループの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

